

JP 2006-515471 A 2006.5.25

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号
特表2006-515471
(P2006-515471A)

(43) 公表日 平成18年5月25日(2006.5.25)

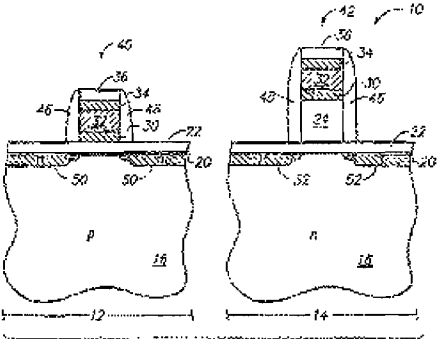
(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (略号)
H O 1 L 27/092 (2006.01)	H O 1 L 27/06 3 2 1 D	4 M 1 0 4
H O 1 L 21/8238 (2006.01)	H O 1 L 29/58 G	5 F 0 4 8
H O 1 L 29/423 (2006.01)	H O 1 L 29/78 3 0 1 G	5 F 0 8 3
H O 1 L 29/49 (2006.01)	H O 1 L 27/10 6 2 1 C	5 F 1 4 0
H O 1 L 29/78 (2006.01)		
審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 24 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号 特願2005-518891 (P2005-518891)	(71) 出願人 505168543 マイクロン テクノロジー、 インク。 アメリカ合衆国 8 3 7 0 6 アイダホ州 、 ボイズ、 サウス フェデラル ウェ イ 8 0 0 0
(86) (22) 出願日 平成16年3月3日 (2004.3.3)	(74) 代理人 100085785 弁理士 石原 昌典
(85) 翻訳文提出日 平成17年9月6日 (2005.9.6)	(72) 発明者 エビック、 デニス、 エム。 アメリカ合衆国、 アイダホ州 8 3 7 0 6、 ボイズ、 サウス サンツリー ウ エイ 3 9 0 5
(86) 国際出願番号 PCT/US2004/006584	(72) 発明者 ウェイマー、 ロナルド、 エイ。 アメリカ合衆国、 アイダホ州 8 3 7 0 6、 ボイズ、 イー、 ヴィクトリー ロード 1 6 9 6
(87) 国際公開番号 W02004/082005	
(87) 国際公開日 平成16年9月23日 (2004.9.23)	
(31) 優先権主張番号 10/388, 103	
(32) 優先日 平成15年3月12日 (2003.3.12)	
(33) 優先権主張国 米国 (US)	
	最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体MOS装置及びCMOS装置、コンデンサ、及び製造方法

(57) 【要約】

回路装置の作製方法を提供する。導電性にドーブされたシリコンと誘電材との間に厚さ20Å以下（または70以下のÅLDサイクルで生じた厚さ）の金属含有材を形成する。導電性にドーブされたシリコンとしてn型を用いることができ、誘電材は高k誘電材を用いることができる。金属含有材は誘電層上へ直接形成でき、導電性にドーブされたシリコンは金属含有材上へ直接形成できる。回路装置はコンデンサ構造体あるいはトランジスタ構造体とすることができる。回路装置がトランジスタ構造体である場合はCMOS装置中へ組み入れることができる。本発明による種々装置はメモリ構造体中へ組み入れられる他、電子システムへも組み入れることができる。



(2)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

PMOS ゲート領域及びNMOS ゲート領域を含む基板を供する工程と、
 前記基板の前記PMOS 及びNMOS ゲート領域上へゲート誘電層を形成する工程と、
 前記PMOS ゲート領域上に存在するが前記NMOS ゲート領域上には存在しないよう
 に、厚さが20 Å以上の厚い金属含有材を形成する工程と、
 前記PMOS 及びNMOS ゲート領域上に薄い金属含有層を形成する工程であって、前
 記薄い金属含有層は厚さが20 Å以下に形成され、前記PMOS ゲート領域上の前記厚い
 金属含有材上へ形成される工程と、
 前記薄い金属含有材上へ前記PMOS 及びNMOS ゲート領域を横切って拡がる導電性 10
 にドーパされたシリコン層を形成する工程と、
 前記PMOS ゲート領域上のPMOS トランジスタ積重ねゲート中へ前記厚い金属含有
 材、前記薄い金属含有材及び前記導電性にドーパされたシリコンを組み入れる工程と、
 前記NMOS ゲート領域上のNMOS トランジスタ積重ねゲート中へ前記薄い金属含有
 材及び前記導電性にドーパされたシリコンを組み入れる工程から構成される、PMOS 装
 置及びNMOS 装置の作製方法。

【請求項 2】

前記導電性にドーパされたシリコンの大部分がn型にドーパされていることを特徴とす
 る請求項 1 項記載の方法。

【請求項 3】

前記ゲート誘電層にタンタル、ハフニウム、及びアルミニウムの1または2以上が含ま
 れることを特徴とする請求項 1 項記載の方法。

【請求項 4】

前記ゲート誘電層が二酸化シリコン上の酸化アルミニウムから成ることを特徴とする請
 求項 1 項記載の方法。

【請求項 5】

前記薄い金属含有材に窒化チタン、窒化タンタル、窒化ハフニウム、及び窒化タングス
 テンの1または2以上が含まれることを特徴とする請求項 1 項記載の方法。

【請求項 6】

前記薄い金属含有材に珪化チタン、珪化タンタル、珪化ハフニウム、及び珪化タングス 30
 テンの1または2以上が含まれることを特徴とする請求項 1 項記載の方法。

【請求項 7】

前記薄い金属含有材の金属がチタン、タンタル、タングステン、及びハフニウムの1ま
 たは2以上から成ることを特徴とする請求項 1 項記載の方法。

【請求項 8】

前記薄い金属含有材の厚さが約15 Å以下であることを特徴とする請求項 1 項記載の方
 法。

【請求項 9】

前記薄い金属含有材の厚さが約10 Å以下であることを特徴とする請求項 1 項記載の方
 法。

【請求項 10】

基板上の誘電層と、
 前記誘電層上のPMOS ゲート及びNMOS ゲートと、
 前記PMOS ゲート内かつ前記誘電層上の20 Å以上の厚さをもつ第一金属含有材と、
 前記NMOS ゲート内かつ前記誘電層上の約20 Å以下の厚さをもつ第二金属含有材と
 、
 前記PMOS ゲート内かつ前記第一金属含有材上のn型にドーパされたシリコンから成
 る第一層と、
 前記NMOS ゲート内かつ前記第二金属含有材上のn型にドーパされたシリコンの第二
 層とから構成されるCMOS。

20

30

40

50

(3)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

【請求項 1 1】

前記誘電層にタンタル、ハフニウム、及びアルミニウムの 1 または 2 以上が含まれることを特徴とする請求項 1 0 項記載の CMOS。

【請求項 1 2】

前記誘電層に酸化アルミニウムが含まれることを特徴とする請求項 1 0 項記載の CMOS。

【請求項 1 3】

前記第一及び第二金属含有材が酸化アルミニウムと物理的に接していることを特徴とする請求項 1 1 項記載の CMOS。

【請求項 1 4】

前記第一及び第二金属含有材が互いに同一の組成をもつことを特徴とする請求項 1 0 項記載の CMOS。

【請求項 1 5】

前記第一及び第二金属含有材が主として窒化チタン、窒化タンタル、窒化タングステン、及び窒化ハフニウムの 1 または 2 以上から成ることを特徴とする請求項 1 4 項記載の CMOS。

【請求項 1 6】

前記第一及び第二金属含有材が主として珪化チタン、珪化タンタル、珪化タングステン、及び珪化ハフニウムの 1 または 2 以上から成ることを特徴とする請求項 1 4 項記載の CMOS。

【請求項 1 7】

前記第二金属含有材の厚さが約 1 5 Å 以下であることを特徴とする請求項 1 0 項記載の CMOS。

【請求項 1 8】

前記第二金属含有材の厚さが約 1 0 Å 以下であることを特徴とする請求項 1 0 項記載の CMOS。

【請求項 1 9】

前記第一金属含有材の厚さが約 1 0 0 Å 以上であることを特徴とする請求項 1 0 項記載の CMOS。

【請求項 2 0】

記第一金属含有材の厚さが約 1 5 0 Å 以上であることを特徴とする請求項 1 0 項記載の CMOS。

【請求項 2 1】

記第一金属含有材の厚さが約 1 5 0 Å 以上であり、前記第二金属含有材の厚さが約 1 5 Å 以下であることを特徴とする請求項 1 0 項記載の CMOS。

【請求項 2 2】

請求項 1 0 項記載の CMOS を含んだ電子システム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0 0 0 1】

本発明はトランジスタ装置（n-チャネル金属酸化膜半導体（NMOS）装置及びp-チャネル金属酸化膜半導体（PMOS）装置を含む）、及び相補性金属酸化膜半導体（CMOS）構造体に関する。本発明はさらにコンデンサ装置、トランジスタ装置及びCMOS構造体の各製造方法に関する。本発明は、より具体的観点において、トランジスタ装置、コンデンサ構造体及び／またはCMOS装置を含む記憶装置に関し、また本発明は一部の観点において動的ランダムアクセスメモリ（DRAM）に関する。さらに本発明はより具体的観点においてコンデンサ構造体、トランジスタ装置及び／またはCMOS装置を含む電子システムに関する。

【背景技術】

【0 0 0 2】

(4)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

例えばトランジスタ装置及びコンデンサ装置を含む種々半導体構造体において高kゲート誘電体を用いることには利点がある。高k誘電体は二酸化シリコンの誘電率よりも大きい誘電率をもつ誘電材料であると理解され、かかる誘電体としては例えば Ta_2O_5 、 Al_2O_3 の他、多数の材料がある。

【0003】

これまで標準的CMOSフロー中へ高k誘電材料を組み入れるいくつかの試みが為されてきた。しかしながら、かかる試みにおいて、典型例としてCMOS構造体のようなシリコンゲート電極と連結して用いる場合にはいくつかの難点があることが見出された。例えば、高kゲート誘電体フィルム上へシリコン（例えば多結晶質シリコン等）を直接蒸着すると、典型例としてシリコンと誘電体との界面に反応層が生ずる。この反応層は、シリコン蒸着中、及び／またはその後におけるシリコンの高温焼鈍し中に生じ得る。この反応層によってシリコンと誘電材料間にケイ酸塩等から成る界面膜が生成される。この界面膜は誘電積重ね構造体の有効誘電率を低下させ、それによって誘電体の計測能が制限される。さらに前記界面層は一部金属原子d状態及び帯電原子欠陥によって電荷トラップ性／固定電荷の発生源となり得る。この電荷トラップ性／固定電荷は後段ゲート焼鈍しによって影響を受け、トランジスタ装置の閾値電圧に制御不能なずれを生ずる可能性がある。さらに、前記閾値電圧はp型の導電性にドーブされたシリコンから高ゲート誘電体中へのホウ素拡散によってずれる可能性もある。このような閾値電圧のずれは例えばメモリセル処理等の高温集合処理にとって特に重要でありかつ問題である。前記誘電体中へのホウ素拡散は高誘電率フィルムを用いて誘電体厚を増加させても問題となり得る。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

上述した理由から、CMOSフロー中へ高k誘電材料を組み入れる新規な方法が開発されることが望ましい。加えて、CMOS装置以外の他の半導体構造体に高k誘電材料が用いられていることから、前記新規方法がCMOSフロー以外の他の半導体作製に適用可能であり、また特にコンデンサ装置作製に適用可能であることが望ましい。また、前記新規方法が高k誘電材料のみならず他の誘電材料にも適用可能であることが望ましい。

【課題を解決するための手段】

【0005】

本発明は一観点として回路装置の作製方法に関する。この方法では、基板上へ誘電層が形成され、この誘電層上へ金属含有材（例えば元素金属、金属珪化物、及び／または金属窒化物；金属としては例えばタングステン、ハフニウム、タンタル及びチタンの1または2以上）が直接形成される。前記金属含有材は約20Å以下の厚さに形成される。続いて、前記金属含有材上へ導電性にドーブされたシリコンが直接形成される。前記回路装置としては例えばトランジスタ装置あるいはコンデンサ装置を挙げることができる。

【0006】

本発明は別の観点としてトランジスタ装置の作製方法に関する。この方法では、基板上へゲート誘電体が直接形成される。前記誘電体上へ金属含有材が約20Å以下の厚さで形成される。前記金属含有材上へ導電性にドーブされたシリコンが形成され、次いで前記金属含有材及び導電性にドーブされたシリコンが積重ねゲートへとパターン化される。次いで前記積重ねゲートの側近にソース／ドレイン部分が設けられる。

【0007】

本発明はさらに別の観点としてCMOSに関する。このCMOSは基板上に誘電層を有する。前記誘電層上にはPMOSゲート及びNMOSゲートがある。前記PMOS内及び前記誘電層上には20Å以上、より典型的には150Å以上の厚さをもつ第一金属含有材がある。前記NMOSゲート内及び前記誘電層上には約20Å以下の厚さをもつ第二金属含有材がある。前記PMOSゲート内及び前記第一金属含有材上にはn型にドーブされたシリコンの第一層があり、前記NMOSゲート内及び前記第二金属含有材上にはn型にドーブされたシリコンの第二層がある。

(5)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

【0008】

本発明はさらに別の観点としてコンデンサ構造体に関する。この構造体は導電性にドーピングされたシリコンから成る第一コンデンサ電極を備える。前記第一コンデンサ電極側近には誘電層があり、前記第一コンデンサ電極から前記誘電層を横切って第二コンデンサ電極が配されている。前記第一コンデンサ電極の前記導電性にドーピングされたシリコンと前記誘電層との間には金属含有材がある。前記金属含有材は20 Å以下の厚さをもつ。

【0009】

本発明に従った種々構造体を、例えばDRAM装置等の記憶装置中へ組み入れることが可能である。また本発明に従った種々構造体を電子システムへ組み入れることも可能である。

10

【発明を実施するための最良の形態】

【0010】

以下に本発明の好ましい実施態様について添付図面を参照しながら説明する。

【0011】

本発明の一観点は、CMOS構造中のNMOS装置及びPMOS装置の双方において、誘電材と導電性にドーピングされたシリコンとの間へ金属含有材を組み込むことが利点となることである。さらに、前記PMOS装置中に用いられる前記金属含有材が前記NMOS装置中に用いられる前記金属含有材よりも実質的に厚く（PMOS装置中の金属含有材の厚さは20 Å以上であり、100 Å以上のことも多く、150 Å以上であることもある）、他方前記NMOS装置中に用いられる前記金属含有材の厚さが薄ければ有利であることが見出されている。前記NMOS装置中に用いられる前記金属含有材の厚さは一般的には20 Å以下であり、15 Å以下であることも多く、さらに10 Å以下であることもある。他方、前記NMOS装置中に用いられる前記金属含有材は一般的には70原子層蒸着（ALD）サイクル以下、しばしば50 ALDサイクル以下、さらには40 ALDサイクル以下で作製され、本発明に適用される際に用いられるALDでは約0.3～約0.4 Å/サイクルの蒸着速度が用いられる。しかしながら、本発明では約0.3～約0.4 Å/サイクルとは異なる蒸着速度を用いるALDも実施可能であることが理解されるべきである。前記NMOS装置中に用いられる金属含有層は該層が薄いため不連続であってもよいが、猶本発明の特定の適用場面には適している。

20

【0012】

特定の態様において、前記金属含有材をチタン、ハフニウム、タンタルあるいはタングステンから構成することができる。例示的金属含有材は、実質的にチタン元素、ハフニウム元素、タンタル元素及びタングステン元素の1または2以上、及び/またはチタン、タンタル、ハフニウム及びタングステンの窒化物及び珪酸塩の1または2以上から成るか、あるいは上記元素等の1または2以上から成る。いくつかの態様においては、前記金属含有材は、望ましくは窒化タンタル、窒化タングステン、窒化ハフニウム及び窒化チタンの1または2以上を含み、あるいは実質的にそれらから成り、あるいはそれらから成るように構成される。

【0013】

特定用途において、誘電材とホウ素でドーピングされたポリシリコン間へ金属含有材を使用することによって、前記誘電材中へのホウ素の外部拡散を軽減し、さらには防止することが可能である。さらに、前記金属含有材と前記p型シリコンの仕事関数の類似性によって前記PMOS装置の閾値電圧のずれが無視できる程度となるように特定の金属含有材を選択することも可能である（適する金属含有材の例示としては窒化チタン及び窒化タングステンが挙げられる）。さらに、高k誘電体とポリシリコン材間へこのような金属含有材を用いることにより、前記誘電材へシリコンが直接接触することによって生ずるケイ酸塩等のケイ酸塩界面層の形成を軽減し、さらには防止することが可能である。

30

【0014】

p型にドーピングされたシリコンと同等の仕事関数をもつ金属含有材のPMOSゲートにおける使用は極めて適する一方、かかる金属含有材のNMOSゲートにおける使用は問題を

40

50

(6)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

生ずる。例えば、窒化チタンはp型ドーパシリコンと同等の仕事関数をもつ金属含有材であるが、窒化チタンの厚い層によってNMOS閾値電圧が窒化チタンを欠くゲートに対しておよそ1Vずれる。この問題は、PMOSゲートにおいて用いた金属含有材の仕事関数と異なる仕事関数をもつ金属含有材をNMOSゲートにおいて用いることによって回避することができる。しかしながら、仕事関数の低い金属は、n型シリコンにとっては適する代替材となるが、高温において極めて不安定となる傾向がある。それゆえ、このような金属は半導体装置作製下において用いられる一般的熱処理条件に対しては適当な材料とはなり得ない。

【0015】

本発明の他の一観点として、NMOS装置内への、n型シリコンの仕事関数とは実質的に異なる仕事関数をもつ極めて薄い金属含有材バリエーション（数個あるいはそれ以下の単層の厚さ）の使用がある。この金属含有材はシリコンと誘電材（酸化アルミニウム等の高k誘電体）との間に配置される。この金属含有材の厚さは、好ましくは前記n型シリコンと前記金属含有材との組合せ仕事関数に対して完全に優位になることが避けられる一方において、前記誘電材とシリコンとの反応を軽減し、さらには防止できる程度に薄く形成される。前記シリコンと誘電材との反応を軽減することにより、従来技術において問題であったシリコンと高k誘電材との界面における電荷トラップを防止することができ、前記NMOS装置の閾値電圧をさらに制御することが可能となる。

【0016】

前記NMOS装置中に用いられる薄い金属含有材バリエーションは、例えば原子層蒸着（ALD）及び／または化学蒸着（CVD）等のいずれか適する方法によって作製可能である。好ましくは、金属含有材の厚さ及び均質性を極めて良好に調節でき、また前記金属含有材と直接物理的に接触する表面下にある誘電体への損傷及びそれとの相互作用を軽減しさらには防止できる原子層蒸着が用いられる。

【0017】

前記金属含有材は一般的には前記誘電材上へ直接形成される。ここで前記用語「上へ直接」とは、CVDを用いて形成される場合は金属含有材が誘電材と物理的に接触して形成され、あるいはALDを用いて形成される場合は金属含有材の形成に用いられる層が誘電材と物理的に接触して蒸着されることを意味する。いくつかの態様においては、金属含有材本体の形成前に誘電材本体上へ界面層を形成して、金属含有材を前記界面層上へ形成することが可能である。前記界面層は例えば窒化シリコンあるいは窒化ハフニウム等の窒化物で構成することができる。前記窒化物は例えば表面特徴的誘電材のエトリデーションによって生成することができる。

【0018】

前記金属含有材上へ形成されるシリコンは、例えば化学蒸着等のいずれか適する方法を用いて形成可能である。導電性を増加させるドーパントは前記蒸着中あるいは前記蒸着後の適当な植込みによって前記シリコン内に形成することができる。

【0019】

前記金属含有材上へシリコンを直接形成することにより（ここで用語「上への直接」とは、化学蒸着処理の場合、シリコンが前記金属含有材と物理的に接触する状態で形成されることを意味する）、前記シリコン及び金属含有材が反応して、例えばチタン・窒素・シリコンから成る材料（TiN、Si_xN_y、ここでx及びyは0より大きい数字を表す）、ハフニウム・窒素・シリコンから成る材料、タンタム・窒素・シリコンから成る材料、あるいはタンタル・窒素・シリコンから成る材料等の金属及びシリコンを含む複合材料を生成することが可能となる。前記複合材料がチタン、窒素及びシリコンから成るのであれば、かかる材料には珪化チタン及び窒化チタンの仕事関数の中間の仕事関数が備えられる。参考資料によれば、珪化チタン及び窒化チタンの仕事関数はそれぞれ3.67～4.25電子ボルト及び4.83～4.95電子ボルトの範囲内である。

【0020】

図1は、平坦帯域電圧（V_{fb}）に対する原子層蒸着された窒化チタンバリエーションの影響

(7)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

を示す高周波キャパシタンス／電圧データを示すグラフである。100 Å厚の窒化チタンバリアは窒化チタン本体の仕事関数を示し、短絡トランジスタ試験においてPMOS閾値電圧に適合することが示されている。窒化チタンフィルムを15 ALDサイクルまで薄膜化することにより（約5 Å～約7 Å厚と推定される）、前記V_{fb}は-300 mVまでずれる。さらに、前記窒化チタンバリアをさらに薄膜化してV_{fb}のずれを生ずることが可能である。図1中のデータは、原子層蒸着5サイクルの窒化チタンが窒化チタンの使用に関して酸化アルミニウムに対し認め得るほどの影響を与えないことを示している。実際、3サイクルから生成された窒化チタン及び5サイクルから生成された窒化チタンのキャパシタンス／電圧曲線は、窒化チタンバリアの介在なしに酸化アルミニウム上へ直接形成されたポリシリコンゲートの同曲線と同一である。キャパシタンス／電圧曲線の広がり 10
は界面状態における増加を示している。かかる増加は、蓄積キャパシタンスの減少とともに、窒化チタンの無存在下、あるいは5またはそれ以下のALDサイクルから生成された窒化チタン存在下（図示されたALDサイクルは窒化チタンの成長比約0.3 Å～約0.4 Åに相当する）における界面ケイ酸塩層の形成を支えている。

【0021】

次に本発明の例示的態様について図2～7を参照しながら説明する。まず図2には第一断片部分12及び第二断片部分14を含んで成る半導体構造体が図示されている。断片部分12及び14はそれぞれNMOS領域及びPMOS領域に相当し、両者が一体化することによりCMOS構造が得られる。

【0022】

構造体10は、NMOS領域12においてp型にドーブされ及びPMOS領域14においてn型にドーブされた基板16を含んで構成されている。基板16は例えばモノクリスタルシリコンから作製することができる。以下に述べる特許請求の範囲の解釈を補完するため、用語「半導電性基板」及び「半導体基板」は、以下に限定されないが、半導電性ウェハー（単体または他材料を上部を含む組合せ体）及び半導電性材料層（単体または他材料を含む組合せ層）等の半導電性材料本体を含めて半導電性材料を含んで成る構造体を意味すると定義される。用語「基板」は、以下に限定されないが、上記半導電性基板を含め、なんらかの支持構造体を指している。

【0023】

基板16上には誘電材18が広がっている。誘電材18は分離した1対の層、すなわち 30
基板20上面へ直接形成された下部薄層20とこの薄層20上へ形成された上部の厚い層22から成る。薄層20は例えば二酸化シリコンから成り、特定用途においては、モノクリスタル基板16上面上へ形成される自然発生酸化物で対応させることも可能である。誘電材22はいずれか適する誘電材で対応可能であり、例えば高k誘電材が用いられる。前記厚い層22は、例えば1または2以上の酸化物、及び／または1または2以上のケイ酸塩から構成することができる。特定用途においては、前記厚い層22はタンタル、ハフニウム及びアルミニウムの1または2以上から成る。前記層は、例えばタンタル酸化物（Ta₂O₅等）、アルミニウム酸化物（Al₂O₃等）、ハフニウム酸化物及び／またはハフニウムケイ酸塩から構成することができ、特定用途においては異種材料（例えばAl₂O₃／HfO₂等）から成る多層に構成することができる。前記多層は例えばナノラミネート 40
であってよい。前記誘電材18は分離された2層として構成されているが、誘電材は単層、あるいは2以上の分離された層にも構成できると理解されなければならない。特定の観点において、二酸化シリコン層20を省略して、誘電層18全体に高k誘電材を用いることが可能である。他の態様として、誘電材全体を例えば二酸化シリコン等の高k誘電材以外の材料で構成することも可能である。

【0024】

誘電材22上には、金属含有材層24が、図示された実施態様では誘電材22に物理的に接した状態で、あるいは言い方を変えれば誘電材22上へ直接形成される。後続して形成される金属含有層と区別するため、前記金属含有層24を厚い金属含有層あるいは第一金属含有層と呼ぶことができる。前記金属含有層24は例えば化学蒸着等の適当な方法に 50

(8)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

よって形成可能である。前記層 24 に用いられる金属としては例えばチタン、タンタル、タングステン、ハフニウム等を挙げることができる。特定の態様においては、前記層 24 は、ハフニウム元素、チタン元素、タンタル元素及びタングステン元素を含み、あるいは実質的にそれら元素から成り、あるいはそれら元素から成るか、あるいはチタン、タンタル、タングステン及びハフニウムの窒化物及び／またはケイ酸塩を含み、あるいは実質的にそれらから成り、あるいはそれらから成るように構成される。前記層 24 は 20 Å 以上の厚さに形成されるが、典型例としては 100 Å 以上の厚さ、例えば 150 Å 以上の厚さに形成される。

【0025】

図 3 では、層 24 材料が PMOS 領域 14 上にはあるが NMOS 領域 12 上にはないよう 10
に層 24 がパターン化されている。この層 24 のパターン化では該層材料がブロック状に形成されている。このようなパターン化は、例えばフォトリソグラフィ処理によって層 24 上へパターン化されたフォトレジストマスク（図示せず）を形成し、層 24 の適当なエッチングによってパターンを前記マスクから前記層へ移し、次いで前記フォトレジストマスクを取り除くことによって達成することができる。但し、図 2 及び 3 に示した手順は、PMOS 領域 14 上にはあるが NMOS 領域 12 上にはない金属含有材ブロック（図 3 には層 24 の一部が残存している）の形成に用いられるいくつかの方法の一例にすぎない。

【0026】

図 4 に示すように、NMOS 領域 12 及び PMOS 領域 14 上へ積重ね層 30、32、20
34 及び 36 が形成される。層 30 は金属含有材から成り、約 20 Å 以下の厚さに形成される。層 30 は、前記第一金属含有層 24 と区別するため第二金属含有層と呼ぶことができる。本発明の図示された態様においては、層 30 は NMOS 領域 12 の全域で誘電材 22 と物理的に接して形成され、また PMOS 領域 14 の全域で前記第一金属含有層 24 と物理的に接して形成される。金属含有層 30 は例えば原子層蒸着によって約 15 Å 以下の厚さに、また特定の態様においては約 10 Å 以下の厚さに形成可能であり、あるいは約 50 以下、あるいは 30 以下の ALD サイクルで形成可能である。第二金属含有層 30 の組成は前記第一金属含有層 24 の組成と同一であっても異なってもよい。金属含有層 30 を主として窒化チタンで構成することも可能である（金属含有層 30 の 50 重量%以上 30
が窒化チタンであってもよい）。あるいは代替例として、金属含有層 30 を主として窒化タンタル、窒化タングステン、あるいは窒化ハフニウムで構成することも可能である。特定の観点から、前記層 30 を、チタン元素、タンタル元素、タングステン元素及びハフニウム元素の 1 または 2 以上を含み、あるいは実質的にそれらから成り、あるいはそれらから成るように構成でき、またチタン、タンタル、タングステン及びハフニウムの窒化物及び／またはケイ酸塩を含み、あるいは実質的にそれらから成り、あるいはそれらから成るように構成することも可能である。

【0027】

前記層 32 は、導電性にドーパされたシリコンを含み、あるいは実質的に該シリコンから成り、あるいは該シリコンから成るように構成することができる（例えば、導電性にドーパされた非結晶シリコン又は導電性にドーパされた多結晶シリコン）。本発明の図示された態様では、シリコン含有層 32 は金属含有層 30 と物理的に接している。また、本発明の図示された態様では、同一の導電性ドーパシリコン層が NMOS 及び PMOS 両領域を横切って延びている。それゆえ、前記導電性ドーパ層 32 の大部分が n 型にドーパされているならば、かかる材料が NMOS 及び PMOS 両領域において利用される。本発明には、NMOS 領域とは異なる導電性ドーパ材料が PMOS 両域に用いられ、あるいは導電性ドーパシリコン材料が NMOS 領域と PMOS 領域のいずれか一方に用いられていない他の態様（図示せず）も含まれることが理解されるべきである。しかしながら、本発明の図示された態様は、同一の導電性ドーパシリコン層が基板の NMOS 及び PMOS 両領域に亘って形成されるならば、加工が簡略される点で好ましいものである。

【0028】

50

(9)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

前記層 3 4 は例えば金属及び／または金属合金から成り、特定の態様においてはタンダステンから成る。

【0029】

前記層 3 6 は例えば窒化シリコン等の電気絶縁性キャップで構成することができる。

【0030】

図 5 に示すように、前記層 3 0、3 2、3 4 及び 3 6 はパターン化され、NMOS 領域 1 2 及び PMOS 領域 1 4 のそれぞれに積重ねゲート 4 0 及び 4 2 が形成される。これらパターン化された積重ね材 4 0 及び 4 2 は、前述した積重ね体と区別するためそれぞれ第一及び第二材と呼ぶことができる。例えば、パターン化されたシリコン層 3 2 は、積重ね体 4 0 中のものは第一シリコン材、また積重ね体 4 2 中のものは第二シリコン材と呼ぶこ 10
とができる。

【0031】

積重ね体 4 0 及び 4 2 間の顕著な相違は、積重ねゲート 4 0 が導電性ドーパントシリコン層 3 2 と誘電材 2 2 との間に薄い金属含有材層 3 0 のみ備える一方、積重ねゲート 4 2 が前記導電性ドーパントシリコン層 3 2 と誘電材 2 2 との間に前記薄い金属含有材層 3 0 に加えて厚い金属含有材層 2 4 を備えることである。

【0032】

好ましくは、積重ねゲート 4 2 中の導電性ドーパントシリコン層 3 2 と誘電材 2 2 との間の前記金属含有材は、積重ねゲート 4 2 の仕事関数が前記金属含有材のみの仕事関数と等しくなるように十分厚く形成される。対照的に、積重ねゲート 4 0 中の前記金属含有材は好 20
ましくは、積重ね体 4 0 の仕事関数が前記金属含有材のみの仕事関数と等しくならない代わりに前記導電性ドーパントシリコン層 3 2 によって調節されるように薄く形成される。しかしながら、前記金属含有材層 3 0 は、好ましくは積重ね体 4 0 の仕事関数が前記金属含有材の仕事関数と等しくならない代わりに、前記金属含有材のみの仕事関数と前記導電性ドーパントシリコンの仕事関数との間の範囲内に含まれるように十分厚く形成される。特定の観点において、NMOS 領域の積重ね体 4 0 中の導電性ドーパントシリコン層 3 2 及び金属含有材層 3 0 の仕事関数は、単一形態での導電性ドーパントシリコン及び金属含有材の仕事関数に対してずれ、また単一形態での金属含有材の仕事関数から少なくとも 50 mV ずれる。

【0033】

NMOS 領域の積重ねゲート 4 0 の仕事関数に導電性ドーパントシリコン層 3 2 が寄与する 30
適用においては、前記材 3 2 のドーパント型の大部分は一般的に n 型である。

【0034】

PMOS 領域の積重ねゲート 4 2 の仕事関数は事実上金属含有材 2 4 の仕事関数であるので、シリコン層 3 2 の導電性型ドーパントは前記積重ねゲートの仕事関数とは無関係である。従って、PMOS 領域の積重ねゲート 4 2 の前記層 3 2 は n 型シリコンあるいは p 型シリコンで構成することができる。しかしながら、積重ねゲート 4 2 のシリコンとしては好ましくは n 型シリコンが用いられる。次いで図 4 に示した処理と同様に、積重ね体 4 2 のシリコンが積重ね体 4 0 のシリコンとともに単一工程で形成される。

【0035】

前記層 3 0、3 2、3 4 及び 3 6 からの積重ねゲート 4 0 の形成は、これら層の材料の 40
NMOS 積重ねゲート中への組込みであると考えることができる。同様に、前記層 2 4、3 0、3 2、3 4 及び 3 6 からの積重ねゲート 4 2 の形成は、これら層の材料の PMOS 積重ねゲート中への組込みであると考えることができる。

【0036】

本発明の特定の態様において、積重ねゲート 4 0 及び 4 2 下方の領域はそれぞれ NMOS ゲート領域及び PMOS ゲート領域と呼ぶことができる。また、積重ねゲート 4 0 及び 4 2 の下の誘電材 2 0 及び 2 2 は、本発明の特定の態様においてゲート誘電層と呼ぶことができる。

【0037】

金属含有層 3 0 と接触する層 3 2 のシリコンは、シリコンと金属含有材との界面におい 50

(10)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

て本発明の種々態様における金属含有材と反応して、金属、シリコン、及びおそらくは窒素を含む組成物を生成する。このような組成物は金属珪化物及び金属含有材の仕事関数の中間に位置する仕事関数を持ち、NMOSゲート40の場合、これら組成物の仕事関数は最終的に前記積重ねゲートの全仕事関数に影響を与える可能性がある。

【0038】

図6に示すように、積重ねゲート40及び42それぞれの側壁に沿って側壁スペーサ46及び48が形成される。スペーサ46及び48は例えば窒化シリコン及び二酸化シリコンの一方または双方を含めた適当な絶縁性材料のいずれかから成り、例えば適当な材料の蒸着及びそれに続く該材料の異方性エッチングによって作製することができる。

【0039】

積重ねゲート40に最も近い基板16内にn型ソース/ドレイン領域50が形成されてNMOSトランジスタ装置の作製が完成し、積重ねゲート42に最も近い基板16内にp型ソース/ドレイン領域52が形成されてPMOSトランジスタ装置の作製が完成される。これらソース/ドレイン領域50及び52は、例えば側壁スペーサ46及び48の形成前及び/または形成後に行われる植込み等のいずれか適当な方法を用いて形成することができる。

【0040】

図2～6に示した加工処理はNMOSトランジスタ及びPMOSトランジスタ（すなわちCMOS構造の作製）に言及して説明したが、本発明の種々態様が単一トランジスタの作製にも利用できることが理解されるべきである。例えば、図6に示したタイプのNMOSトランジスタは種々回路装置中へそれだけを組み入れるようにも作製可能である。

【0041】

前記NMOSトランジスタ装置の作製に関して上述した加工処理は、たとえばコンデンサ装置等の他の装置の作製においにも利用可能である。かかる他装置作製への利用については、DRAMユニットセル102を備える構造体100を示した図7を参照して説明する。このDRAMユニットセルには、コンデンサ構造体106及びビット線130へ電気的に接続されたソース/ドレイン領域107を有するトランジスタ構造体104が含まれている。

【0042】

トランジスタ構造体104はNMOS構造体として示されている。従ってソース/ドレイン領域107はn型ドープ領域である。前記ソース/ドレイン領域はp型基板108中へ延びている。基板108は例えばモノクリスタルシリコンを含めたいずれか適当な構造体から構成できる。トランジスタ装置104にはさらにゲート誘電体112によって基板108から分離された導電性ゲート110が含まれる。ゲート誘電体112は例えば二酸化シリコン及び/または高k誘電材を含めたいずれか適当な材料から作製することができる。導電性ゲート110はいずれか適当な材料または複数材料を組み合わせることで作製することができる。特定の態様において、図7に示したNMOSトランジスタ装置は図6に示したNMOS装置に対応する。従ってゲート110には層30、32及び34が含まれている。他の態様において、ゲート110を従来の構造体で構成することも可能である。

【0043】

導電性ゲート材110上には絶縁性キャップ114が形成され、前記導電性ゲート材の側壁に沿って絶縁性側壁スペーサ116が形成される。キャップ114及びスペーサ116は例えば二酸化シリコン及び窒化シリコンの一方または双方を含めたいずれか適当な材料から作製可能である。

【0044】

トランジスタ装置104の上方及び周囲には電気絶縁性材118が広がっている。この絶縁材118は例えば硼リン珪酸ガラス（BPSG）等のいずれか適当な材料の1または2以上から作製することができる。

【0045】

前記絶縁材118を貫通し前記ソース/ドレイン領域107の一方にまで至る開口部が

(11)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

広がっている。この開口部内には導電性ペダスタル120があり、このペダスタルは前記ソース／ドレイン領域と電気的に接続されている。前記導電性ペダスタルは例えば導電性にドーパされたシリコン、金属及び／または金属化合物等のいずれか適当な導電性材料から作製することができる。

【0046】

前記絶縁材118中の前記開口部内にはコンデンサ構造体106が延び、該コンデンサ構造体は導電性ペダスタル120と電気的に接続されている。コンデンサ構造体106には蓄積ノード122、誘電材124及び金属含有材126が含まれている。

【0047】

前記蓄積ノード122は例えば導電性にドーパされたでこぼこのあるシリコン（例えば 10
半球形粒状シリコン等）のようないずれか適当な導電性材料から作製することができる。

【0048】

前記誘電材124は例えば高k誘電材（例えば図2の誘電領域18に関して前述した高k材料等）及び／または二酸化シリコン、及び／または二酸化シリコンと窒化シリコンの混合物等のいずれか適当な材料から作製することができる。特定の態様において、前記誘電材124を酸化アルミニウムと、蓄積ノード122の導電性ドーパシリコンと酸化アルミニウムとの間にある薄層形状の二酸化シリコン（図示せず）から作製することができる。

【0049】

前記金属含有材126は前記層30の金属含有材に関して前述した組成と同一の組成と 20
し、例えばALDまたはCVDによって形成可能である。

【0050】

コンデンサ電極128は例えば導電性ドーパシリコンで作製でき、p型あるいはn型のいずれにもドーパ可能である。前記薄膜状の金属含有材126をコンデンサ板128の導電性ドーパシリコンと組合せて用いることの利点は、前記材126及び128を含む積重ね体の仕事関数を調節及び変調できることである。

【0051】

金属含有材126は誘電材124と第二コンデンサ電極128との間に図示されているが、かかる構成に代えあるいは加えて、金属含有材を前記誘電材と前記コンデンサ蓄積ノードとの間に形成してもよい。

30

【0052】

本発明の方法論に従って形成されたでこぼこ状の半導体材料を含む回路装置は例えばコンピュータシステム及び他の電子システム等の多数の組立装置に利用可能である。

【0053】

図8は、本発明の一観点に従ったコンピュータシステム400の例示的であって限定でない実施態様を全体的に示した図である。このコンピュータシステム400にはモニター401または他の出力装置、キーボード402または他の通信入力装置、及びマザーボード404が含まれる。マザーボード404にはマイクロプロセッサ406または他のデータ処理ユニット、及び少なくとも1台の記憶装置408が搭載されている。記憶装置408は、例えばトランジスタ装置、CMOS構造体、コンデンサ構造体及びDRAMユニットセル等の本発明の種々態様から構成することができる。記憶装置408をメモリセルアレイから構成し、このアレイを該アレイ中の個々のメモリセルへアクセスするためのアドレス指定回路構成と連結させることができる。さらに、前記メモリセルアレイをメモリセルからデータを読み出す読出回路へ連結させることができる。前記アドレス指定及び読出回路構成を用いて記憶装置408とプロセッサ406間で情報の伝達を行うことが可能である。図9にはこのような構成がマザーボード404のブロック図中に示されている。このブロック図においてはアドレス指定回路構成は符号410で示され、読出回路構成は符号412で示されている。

40

【0054】

本発明の特定の態様においては、記憶装置408はメモリモジュールに相当する。例え 50

(12)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

ば、本発明の教示を利用した実施において、シングルインラインメモリモジュール（S I M M）及びデュアルインラインメモリモジュール（D I M M）を用いることができる。記憶装置のメモリセルから読出し及びメモリセルへ書き込む種々方法を提供する多様な設計のいずれにもこのような記憶装置を組み入れることが可能である。その方法の一つとしてページモード操作がある。D R A M中におけるページモード操作は、メモリセルアレイの行をアドレス指定して該アレイの異なる列へランダムにアクセスする方法として定義される。その列へのアクセス中に、行及び列の共通部分に記憶されたデータを読出し及び出力することが可能である。

【0055】

上記に代わるタイプの装置として、アドレス指定された列が閉じられた後に出力として 10
有効なメモリアレイアドレスへのデータ記憶を可能とする拡大データ出力（E D O）メモリがある。このメモリは、メモリ出力データがメモリバス上において有効である時間を減ずることなく信号へのアクセスを短縮することによって通信速度をある程度速めることができる。他の代替可能なタイプの装置として、S D R A M、D D R S D R A M、S L D R A M、V R A M及びダイレクトR D R A Mがある他、S R A Mあるいはフラッシュメモリ等の他の装置もある。

【0056】

図10は、本発明に係る例示的電子システム700の種々実施態様の高レベル構成を簡略化して示した図である。前記システム700は、例えばコンピュータシステム、プロセス制御システム、あるいはプロセッサ及び付帯メモリを用いるいずれか他のシステムであ 20
ってもよい。電子システム700には、プロセッサあるいは算術論理演算器（A L U）702、制御装置704、メモリ装置706、及び入力／出力（I／O）装置708が備えられる。電子システム700には通常、データに対してプロセッサ702によって行われる操作及びプロセッサ702、メモリ装置706及びI／O装置708間の相互作用を規定する命令処理が備えられている。前記制御装置704は、メモリ装置706から指示を引き出させ及び実行させる一連の操作を持続的に循環させることによりプロセッサ702、メモリ装置706及びI／O装置708の操作を調整する。種々実施態様において、前記メモリ装置706には、以下に限定されないが、ランダムアクセスメモリ（R A M）装置、読出し専用メモリ（R O M）、及びフロッピーディスクドライブ及びコンパクトディスクC D - R O Mドライブ等の周辺機器が含まれる。当業者は、本願開示を読み理解した 30
ならば、図示された電子構成部分のいずれもが本発明の種々態様に従った構成部分を含むように作製可能であることを理解するであろう。

【0057】

図11は例示的電子システム800の種々実施態様における高レベル構成を簡略的に示したブロック図である。このシステム800は、メモリセル804のアレイを備えるメモリ装置802、アドレスデコード806、行アクセス回路構成808、列アクセス回路構成810、操作制御のための読出し／書き込み制御回路構成812、及び入力／出力回路構成814から構成される。前記メモリ装置802には、電力回路構成816及び、メモリセルが低閾値処理状態にあるか、あるいは高閾値非処理状態にあるかを検知する電流センサ等のセンサ820がさらに含まれている。図示された電力回路構成816には、電力供給回路構成880、基準電圧を与える回路構成882、第一ワード線へパルスを与える回路構成884、第二ワード線へパルスを与える回路構成886、及びビット線へパルスを与える回路構成888が含まれる。前記システム800にはプロセッサ822あるいはメモリアクセスのためのメモリ制御装置も含まれている。 40

【0058】

前記メモリ装置802はプロセッサ822からの制御信号824を配線あるいは金属化ラインを通して受信する。メモリ装置802はI／Oラインを介してアクセスされるデータを記憶するために用いられる。回路構成及び制御信号をさらに追加すること、及び本発明の明瞭な理解のためメモリ装置802が単純化されていることは当業者によって認識されるところである。プロセッサ822あるいはメモリ装置802の少なくとも一方へ本開 50

(13)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

示において前述したタイプのDRAMセル、CMOS、コンデンサあるいはトランジスタを含ませることも可能である。

【0059】

本願開示において図示された種々システムは、本発明に係る回路構成及び構造体の適用について全体的な理解を得ることを意図したものであり、本発明の態様に従ったメモリセルを用いる電子システムのすべての構成要素及び特徴を完全に記載することを意図したものではない。プロセッサとメモリ装置間の通信時間を減ずるため、種々電子システムを単一パッケージ処理ユニットに、あるいはさらに単一の半導体チップ上に作製できることは当業者の理解するところである。

【0060】

10

メモリセルの適用用途としては、メモリモジュール、装置ドライバ、電力モジュール、通信モデム、プロセッサモジュール、及びアプリケーション専用モジュールがあり、さらに多層マルチチップモジュールも含まれる。またかかる回路構成は、時計、テレビ、携帯電話、パーソナルコンピュータ、自動車、産業制御システム、航空機、その他の種々電子システムの下位構成部分ともなり得るものである。

【図面の簡単な説明】

【0061】

【図1】 酸化アルミニウムと多結晶質シリコンとの間に原子層蒸着（ALD）された窒化チタンを含む種々構造体についての電圧とキャパシタンス（単位：ミリピコファラド）の相関性を示すグラフである。前記窒化チタンの厚さに関しては、チタン層が存在しない場合、窒化チタン層の形成に特定数のALDサイクルが用いられている場合、及び100 Å厚の窒化チタンが存在する場合に分けてグラフ中に挿入記載されている。各ALDサイクルは約0.3 Åから約0.4 Åまでの窒化チタンの成長速度に対応している。

20

【図2】 予備加工段階にある半導体ウェハース構造体の断片の対を示した略断片図である。

【図3】 図2に示した段階に後続する加工段階にある図2のウェハース断片を示した図である。

【図4】 図3に示した段階に後続する加工段階にある図2のウェハース断片を示した図である。

【図5】 図4に示した段階に後続する加工段階にある図2のウェハース断片を示した図である。

30

【図6】 図5に示した段階に後続する加工段階にある図2のウェハース断片を示した図である。

【図7】 本発明の別の実施態様に従った半導体ウェハース断片をDRAMセルとともに示した略断片断面図である。

【図8】 本発明の適用例を示すコンピュータの略図である。

【図9】 図8に示したコンピュータのマザーボードの特定の特徴を示すブロック図である。

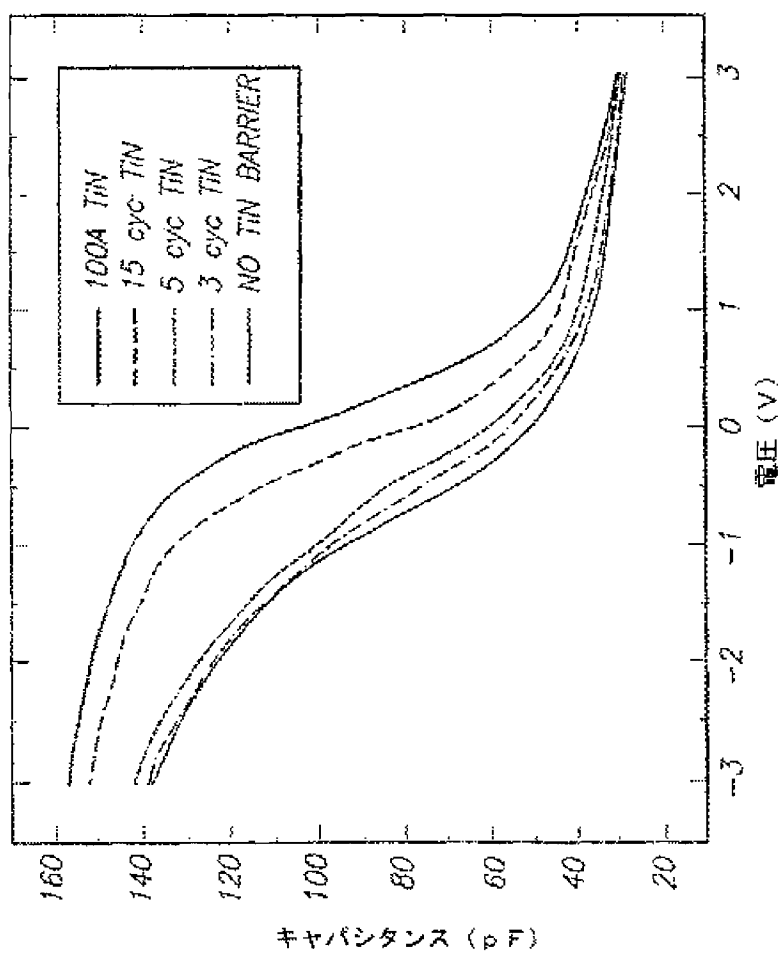
【図10】 本発明の例示的観点に従った電子システムの高レベルブロック図である。

【図11】 本発明の一観点に従った例示的電子システムを簡略化したブロック図である。

(14)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

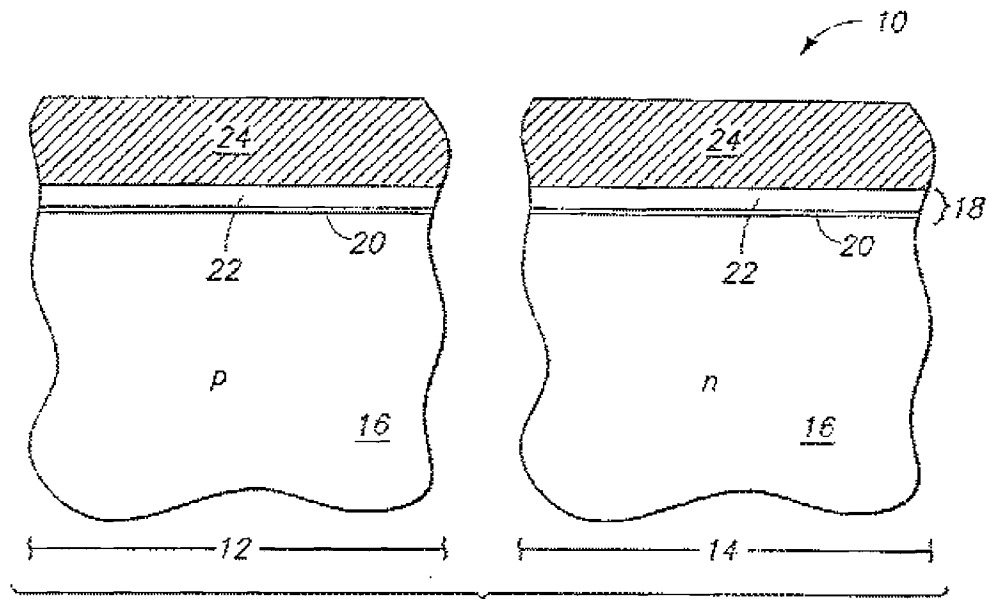
【図 1】



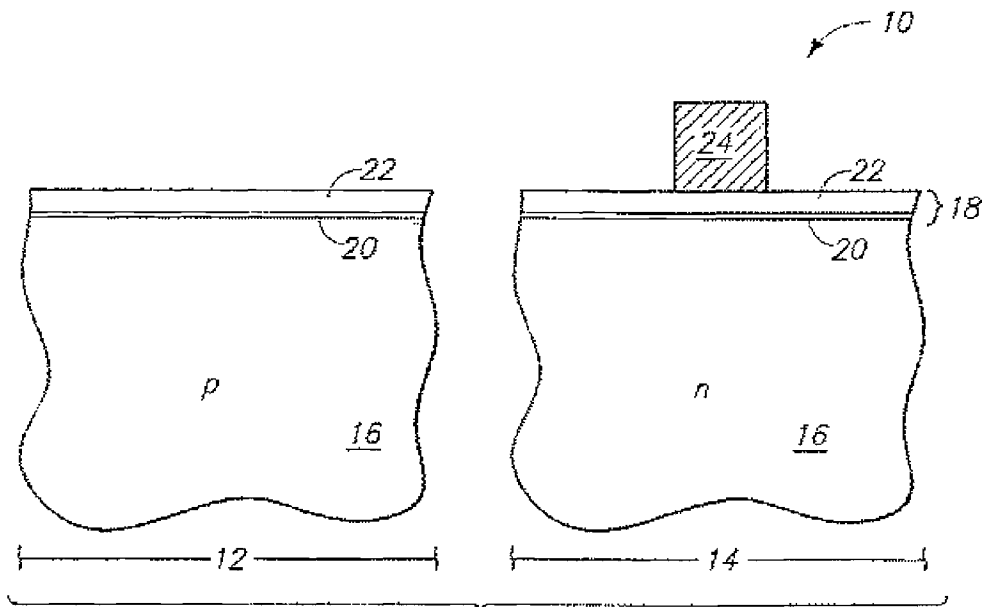
(15)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

【図 2】



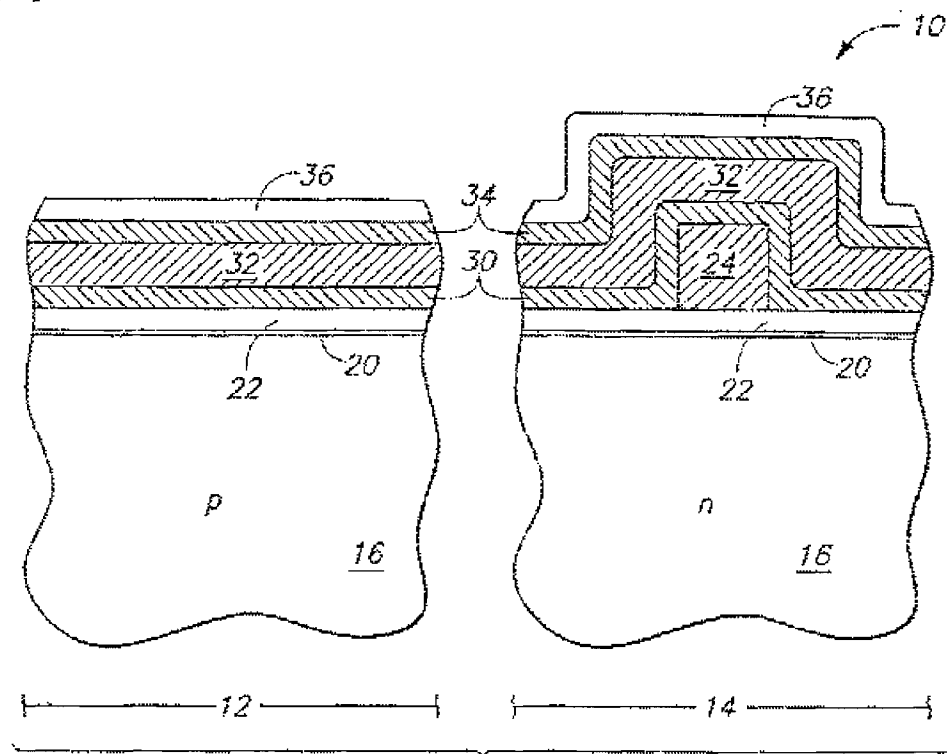
【図 3】



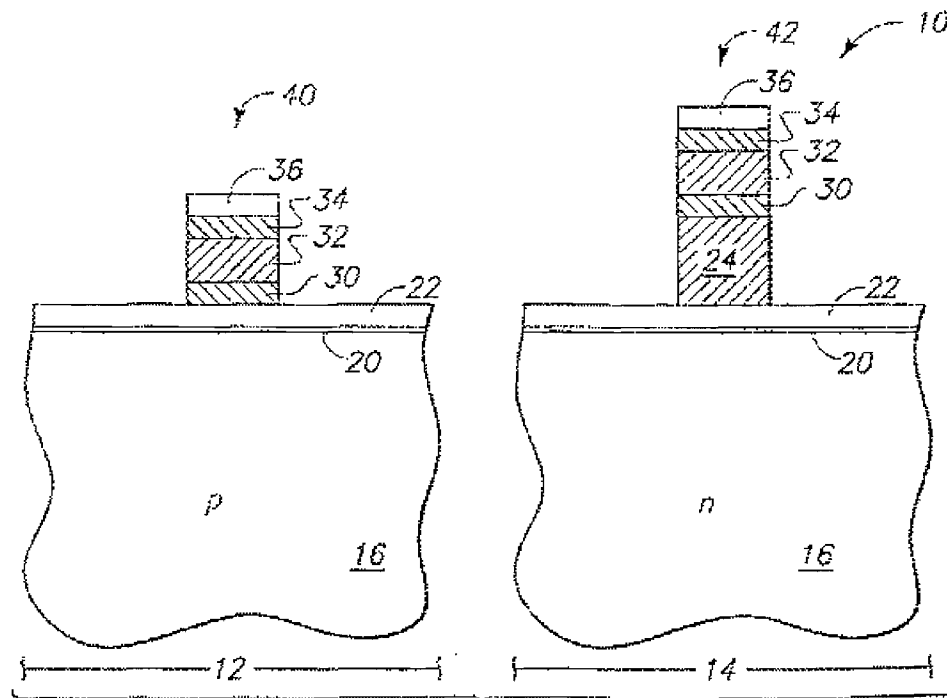
(16)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

【図 4】



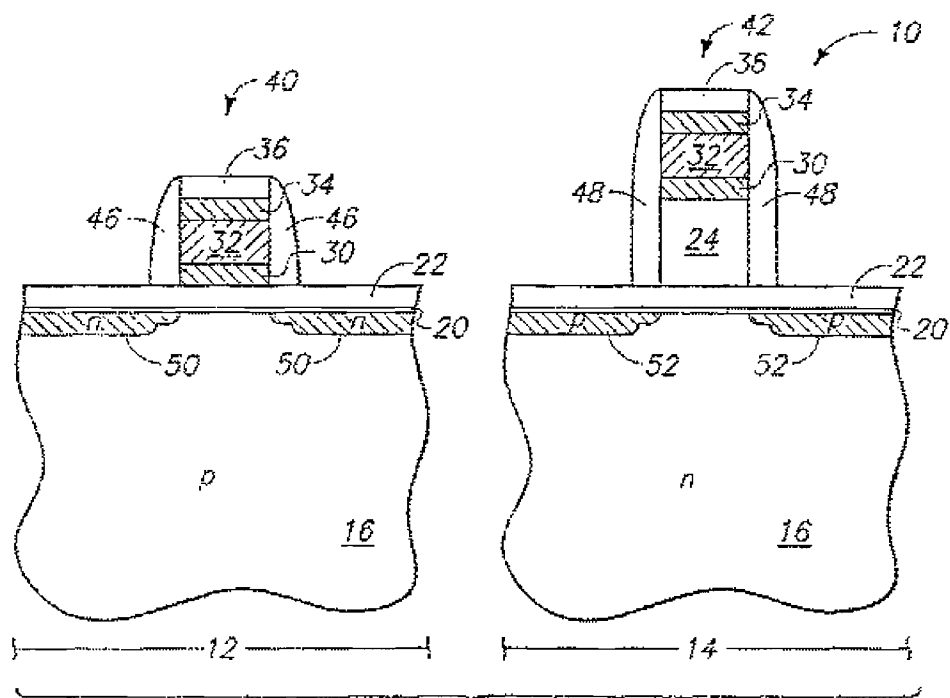
【図 5】



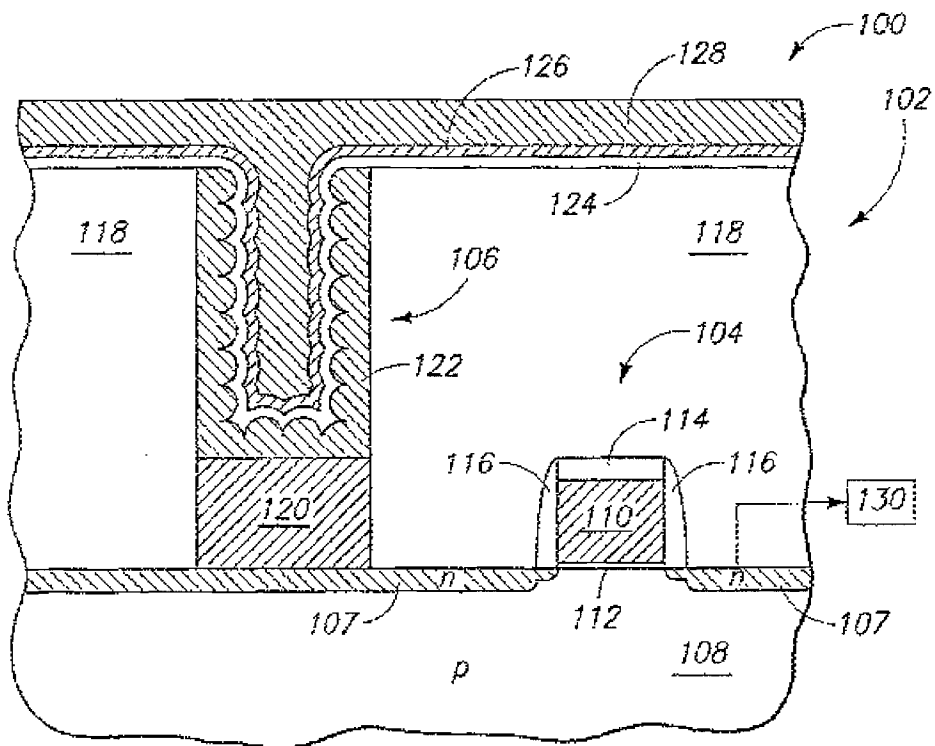
(17)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

【図 6】



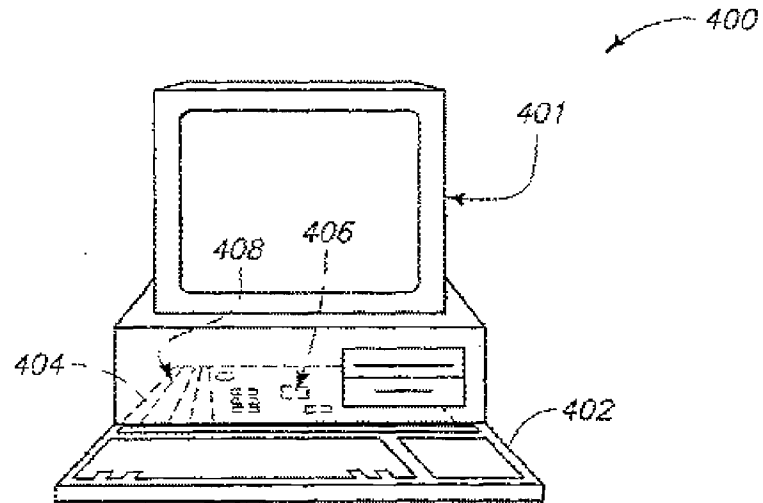
【図 7】



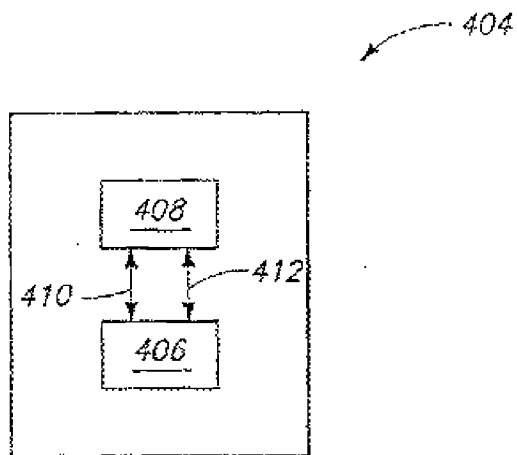
(18)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

【図 8】



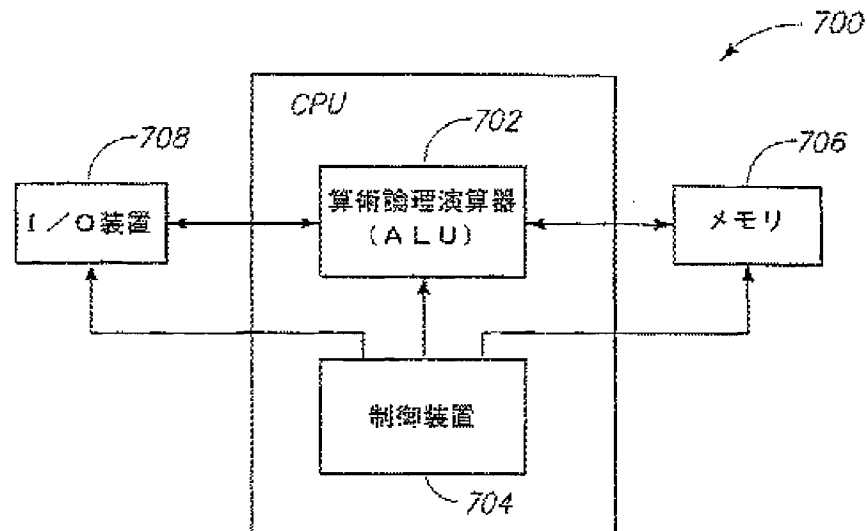
【図 9】



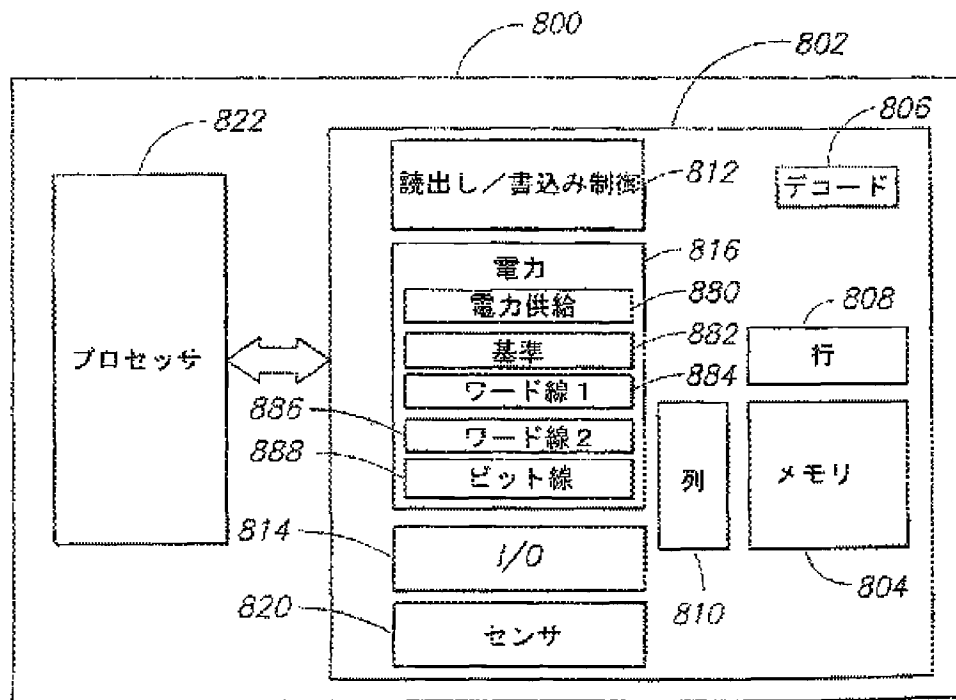
(19)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

【図 10】



【図 11】



【手続補正書】

【提出日】平成17年9月6日(2005.9.6)

(20)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

PMOS 装置及び NMOS 装置の作製方法であって、該方法は、
PMOS ゲート領域及び NMOS ゲート領域を含む基板を供する工程と、
前記基板の前記 PMOS 及び NMOS ゲート領域上へゲート誘電層を形成する工程と、
前記 PMOS ゲート領域上に存在するが前記 NMOS ゲート領域上には存在しないように、厚さが 20 \AA 以上の厚い金属含有材を形成する工程と、
前記 PMOS 及び NMOS ゲート領域上に薄い金属含有層を形成する工程であって、前記薄い金属含有層は厚さが 20 \AA 以下に形成され、前記 PMOS ゲート領域上の前記厚い金属含有材上へ形成される工程と、
前記薄い金属含有材上へ前記 PMOS 及び NMOS ゲート領域を横切って拡がる導電性にドーピングされたシリコン層を形成する工程と、
前記 PMOS ゲート領域上の PMOS トランジスタ積重ねゲート中へ前記厚い金属含有材、前記薄い金属含有材及び前記導電性にドーピングされたシリコンを組み入れる工程と、
前記 NMOS ゲート領域上の NMOS トランジスタ積重ねゲート中へ前記薄い金属含有材及び前記導電性にドーピングされたシリコンを組み入れる工程と、
から構成される PMOS 装置及び NMOS 装置の作製方法。

【請求項 2】

前記導電性にドーピングされたシリコンの大部分が n 型にドーピングされていることを特徴とする請求項 1 項記載の方法。

【請求項 3】

前記ゲート誘電層が二酸化シリコン上の酸化アルミニウムから成ることを特徴とする請求項 1 項記載の方法。

【請求項 4】

基板上の誘電層と、
前記誘電層上の PMOS ゲート及び NMOS ゲートと、
前記 PMOS ゲート内かつ前記誘電層上の 20 \AA 以上の厚さをもつ第一金属含有材と、
前記 NMOS ゲート内かつ前記誘電層上の約 20 \AA 以下の厚さをもつ第二金属含有材と、
、
前記 PMOS ゲート内かつ前記第一金属含有材上の n 型にドーピングされたシリコンから成る第一層と、
前記 NMOS ゲート内かつ前記第二金属含有材上の n 型にドーピングされたシリコンの第二層と、
から構成されることを特徴とする CMOS。

【請求項 5】

前記誘電層にタンタル、ハフニウム、及びアルミニウムの 1 または 2 以上が含まれることを特徴とする請求項 4 項記載の CMOS。

【請求項 6】

記第一金属含有材の厚さが約 150 \AA 以上であり、前記第二金属含有材の厚さが約 15 \AA 以下であることを特徴とする請求項 4 項記載の CMOS。

【請求項 7】

請求項 4 項記載の CMOS を含んだ電子システム。

(21)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.
PCT/US2004/006584A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H01L21/28 H01L29/49

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimized documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H01L

Documentation searched other than minimized documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2003, no. 05, 12 May 2003 (2003-05-12) - & JP 2003 023152 A (SONY CORP), 24 January 2003 (2003-01-24)	1-8, 11-21, 24-34, 37-39, 58-64, 66-73, 76-81
Y	abstract; figures 1,2	9,10,22, 23,35, 36, 46-57, 65,74, 75,82-94
Y	US 2001/024387 A1 (HAKKA SUBT P ET AL) 27 September 2001 (2001-09-27) paragraph '0123; - paragraph '0133; figure 2	80-87, 82-84

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may furnish doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another claim or other special reason (see specification)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to substantiate the priority or novelty of the invention

X document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, each combination being obvious to a person skilled in the art

Z document member of the same patent family

Date of the latest completion of the international search

15 July 2004

Date of mailing of the international search report

22/07/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.O. Box 1, Dusseldorf 2
NL - 2280 HH Rijswijk
Tel: (+31-70) 340-6040, Tr. 30 051 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-2016

Authorized officer

Nesso, S

Form PCT/ISA/210 (October 2003) (January 2004)

page 1 of 2

(22)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/US2004/006584

C. (Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citations of documents, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 2002/086507 A1 (CHO HEUNG JAE ET AL) 4 July 2002 (2002-07-04) the whole document	9, 22, 35, 65, 74
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 02, 26 February 1999 (1999-02-26) & JP 10 303412 A (SONY CORP), 13 November 1998 (1998-11-13) abstract	10, 23, 36, 75
A	US 2002/024080 A1 (SANDHU GURTEJ S ET AL) 28 February 2002 (2002-02-28) the whole document	40-57, 82-94
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2002, no. 04, 4 August 2002 (2002-08-04) & JP 2001 339061 A (UNIV NAGOYA), 7 December 2001 (2001-12-07) abstract	1-94
A	US 2002/153573 A1 (NOGAMI TOHRU) 24 October 2002 (2002-10-24) the whole document	1-94

Form PCT/ISA/210 (continuation of section C of the International Search Report)

page 2 of 2

(23)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No.

PCT/US2004/006584

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
JP 2003023152 A	24-01-2003	WO 03009390 A1 TW 563254 B US 2004014305 A1	30-01-2003 21-11-2003 22-01-2004
US 2001024387 A1	27-09-2001	JP 2001200363 A TW 486771 B	24-07-2001 11-05-2002
US 2002086507 A1	04-07-2002	KR 2002056260 A CN 1363949 A JP 2002237469 A TW 516131 B	10-07-2002 14-08-2002 23-08-2002 01-01-2003
JP 10303412 A	13-11-1998	NONE	
US 2002024080 A1	28-02-2002	NONE	
JP 2001339061 A	07-12-2001	NONE	
US 2002153573 A1	24-10-2002	JP 3287403 B2 JP 2000243853 A GB 2348318 A, B	04-06-2002 08-09-2000 27-09-2000

(24)

JP 2006-515471 A 2006.5.25

フロントページの続き

(51)Int.Cl.

F I

テーマコード(参考)

H 0 1 L 21/8242 (2006.01)

H 0 1 L 27/108 (2006.01)

(81)指定国

AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

F ターム(参考) 4M04 BB01 BB13 BB14 BB17 BB18 BB24 BB25 BB27 BB28 BB29
 BB30 BB32 BB33 BB40 CC05 DD43 EE03 EE15 EE16 FF13
 FF17 FF18 GG09 GG10 GG14 GG16
 5F048 AA07 BA01 BB04 BB06 BB07 BB08 BB09 BB10 BB11 BB13
 BB15 BC05 BE03 DA19 DA20 DA23 DA25 DA27 DA30
 5F083 AD01 AD10 AD21 AD31 AD49 AD60 AD62 JA03 JA06 JA12
 JA19 JA33 JA56 PR21
 5F140 AA06 AA28 AB03 AB09 AC32 BA01 BD01 BD02 BD05 BD11
 BD12 BD13 BE09 BE10 BF03 BF07 BF08 BF09 BF10 BF14
 BF18 BF19 BF20 BF21 BF22 BF24 BF27 BF34 BF56 BG08
 BG09 BG12 BG14 BG22 BG27 BG28 BG31 BG52 BG53 BH14
 CB08